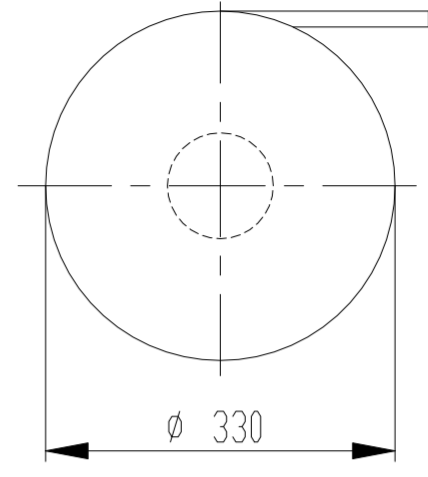
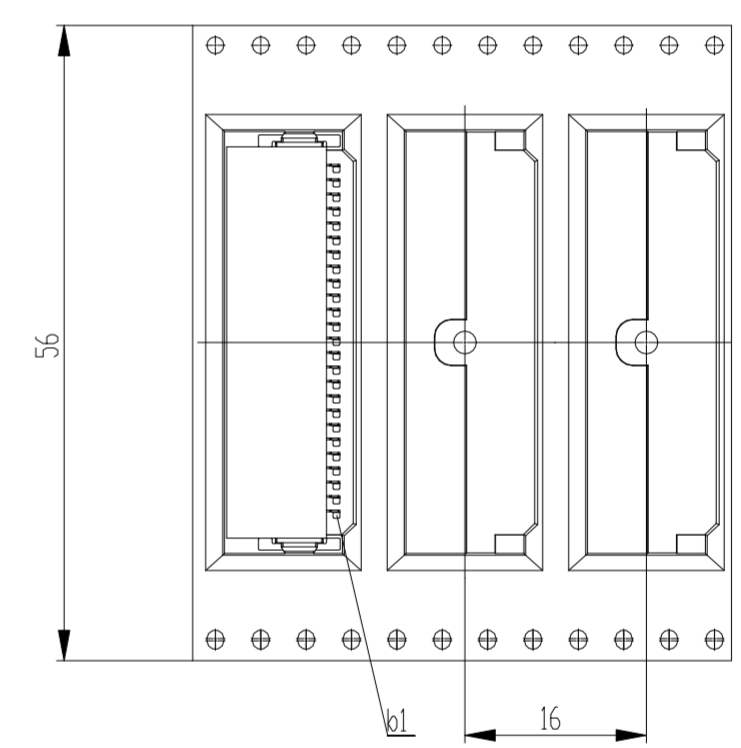
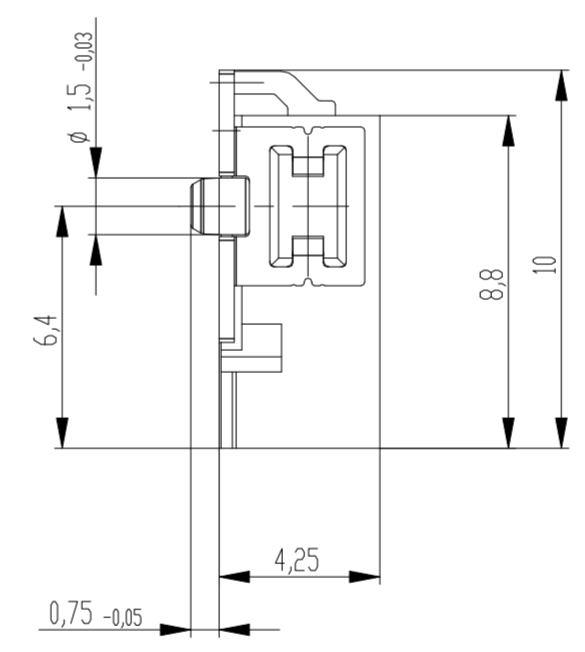


Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT  
PCB-Layout Proposal for SMT

Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3  
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3  
Verpackungseinheit: 560 Stück  
packaging unit: 560 pcs



Abspulrichtung - reel off direction



Anforderungsstufe 1  
performance level 1  
Kontaktbereich vergoldet  
mating area gold plating  
Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm  
terminal area 4-6 µm tin plating  
Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm  
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

BA7-03 - Standard Bauhöhe  
type7-03 - Standard Assembly Height

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der  
Herabgabe bei Übersetzungen von den englischen Originalen. Die  
englische Originalversion dieser Zeichnung ist die verbindliche  
Version für den Fall der Fälle. Änderungen oder Ergänzungen  
an dieser Zeichnung sind nur durch eine schriftliche Genehmigung  
des Herstellers zulässig. In case of any deviation the English version shall prevail.  
 All rights reserved in the event of a patent, utility model or design.  
 The information contained herein is for reference only. The information  
contained herein is not intended to constitute an offer of any product.  
 The information contained herein is for reference only. The information  
contained herein is not intended to constitute an offer of any product.  
 The information contained herein is for reference only. The information  
contained herein is not intended to constitute an offer of any product.

Dimension no.	Tolerances Din. for Information ISO 8015	Scale 5:1 Material	ERNI-Messerl. SMC-B 50-SMD-BA7-03 Male SMC-B 50-SMD-type7-03
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	TE Connectivity	1 A2
f	28.01.2020	Class	SMCB
Index	Date		

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)